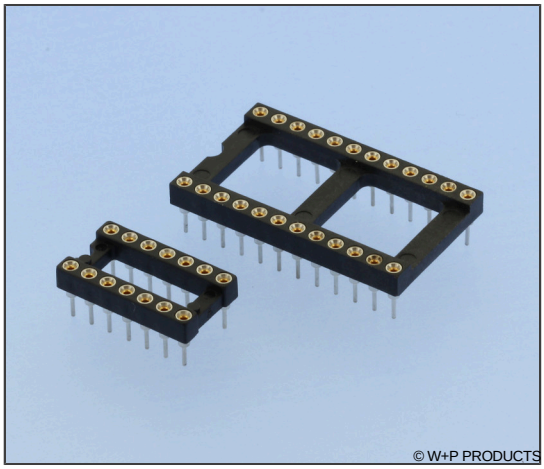
169

IC-Fassungen RM 2,54mm – Bauhöhe 4,2mm

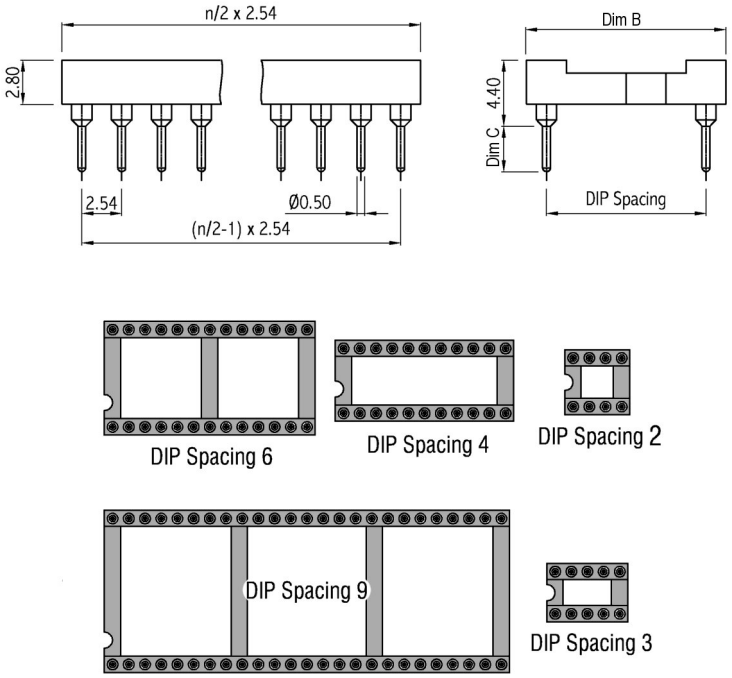
IC Sockets, 2.54mm Pitch – 4.2mm Profile

Technische Daten / ***Technical Data***

Gehäuse/Abdeckung/Hebel	Thermoplast, nach UL94 V-0
Case/Cover/Actuator	*Thermoplastic, rated UL94 V-0*
Kontaktmaterial	Hülse: Messing gedreht Feder: 4-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer
Contact Material	*Sleeve: screw machined brass* *Clip: 4-Finger-Clip, Beryllium-Copper*
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	*Acc. to options (see below), over Ni*
RoHS-Ausnahmen 6a-I / 6c	6c
RoHS Exemptions 6a-I / 6c	*6c*
Durchgangswiderstand	< 10 mΩ
Contact Resistance	*< 10 mΩ*
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	*> 1000 MΩ*
Spannungsfestigkeit	1 kV RMS
Test Voltage	*1 kV RMS*
Nennspannung	100 V RMS / 150 V DC
Voltage Rating	*100 V RMS / 150 V DC*
Nennstrom	1 A
Current Rating	*1 A*
Temperaturbereich	-55 °C ... +125 °C
Temperature Range	*-55 °C ... +125 °C*
Verarbeitung	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren
Processing	*Wave or reflow soldering*



Für Rundstifte Ø0,40-0,56mm
oder Vierkantstifte 0,25x0,45mm.
For Ø0.40-0.56mm round pins
or 0.25x0.45mm rectangular pins.



Standardoptionen
Standard Options

n	DIP (Code)	DIP [mm]	Dim B [mm]
10	2	5.08	7.6
04-24	3	7.62	10.1
28			
20-24	4	10.16	12.6
28			
32			
10	6	15.24	17.7
24			
28			
32			
36			
40-42			
48-52			
50-52	9	22.86	25.3
64			

Series	***Contacts****	***DIP Spacing****	***Sleeve Plating***	***Clip Plating****	***Dim C****
169	**14**	**3**	**50**	**00**	**..**
169 IC-Fassung *IC-Socket*	**04-24/28/32/36/** **40-42/48-52** DIP Spacing Optionen entspr. Tabelle *DIP Spacing Options* *pl. see table*	**2** 5,08mm **3** 7,62mm **4** 10,16mm **6** 15,24mm **9** 22,86mm	**50** Verzinnt (Standard) *Tin plated (Standard)*	**00** Vergoldet *Gold plated* **10** Vergoldet 0,25µm (Option) *0.25µm gold plated (Option)* **30** Vergoldet 0,75µm *0.75µm gold plated*	**[ ]** C=2.90mm (Standard) **41** C=4.10mm **50** C=5.00mm **55** C=5.45mm **70** C=7.00mm

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
** This is an **order example** -*
please replace by your specifications.

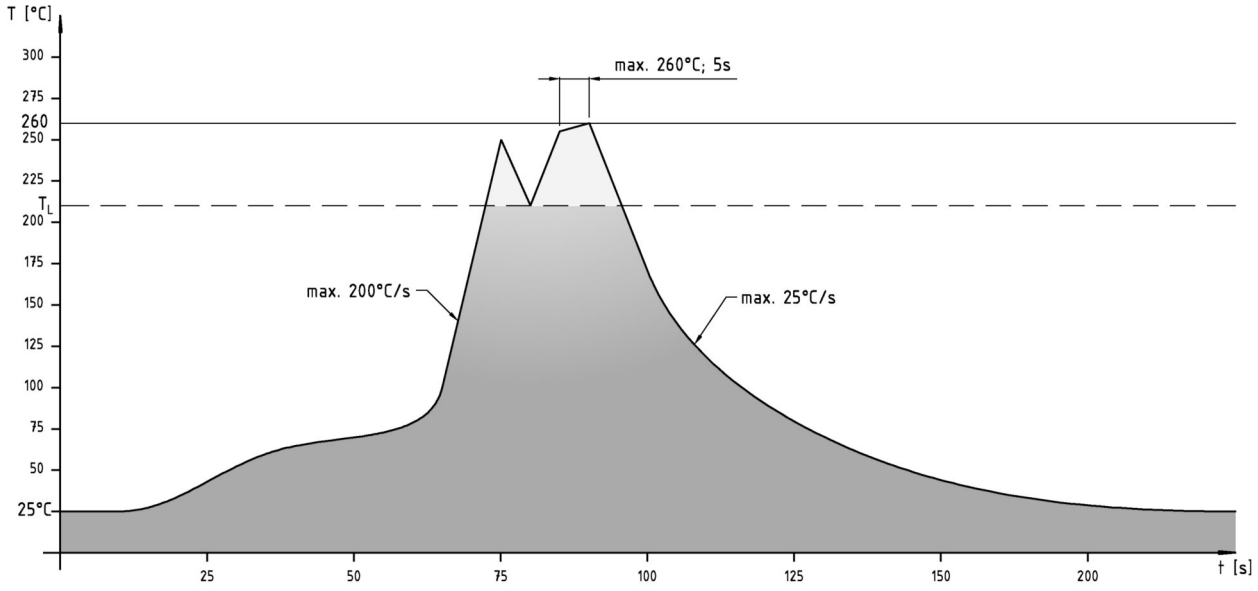
Downloaded from Arrow.com.

Informationen zum Wellen-Lötverfahren
Wave Soldering Information

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Empfohlenes Wellenlötprofil:



Downloaded from Arrow.com.

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

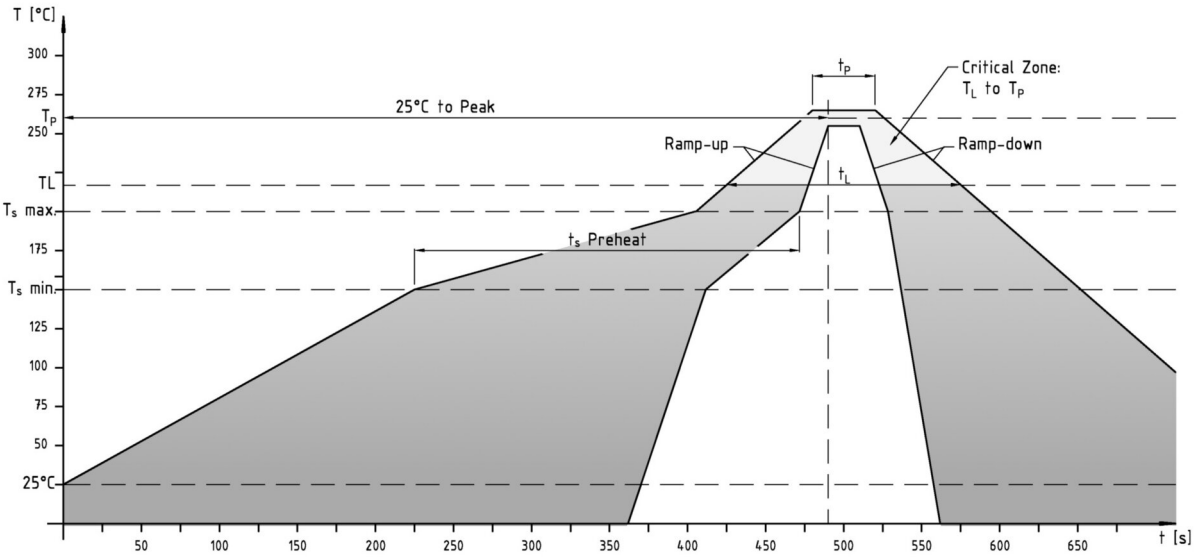
Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_S$min	150 °C
Temperatur Maximum $T_S$max	200 °C
Dauer $T_S$min – $T_S$max	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_S$max – T_P	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_P$max – $T_S$min	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_S$min	*150 °C*
Maximum Temperatur $T_S$max	*200 °C*
Duration $T_S$min – $T_S$max	*60 – 180s*
Soldering Range Temperature T_L	*217 °C*
Duration above T_L	*60 – 180s*
Ramp-Up Rate $T_S$max – T_P	*max. 3 °C / s*
Peak Temperature T_P	*260±5 °C*
Duration Peak Temperature	*20 – 40s*
Ramp-Down Rate $T_P$max – $T_S$min	*6 °C / s*
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	*max. 8min*



Downloaded from Arrow.com.